

Title (en)

Process and device for electrolytic pickling of metal strips

Title (de)

Verfahren und eine Vorrichtung zum elektrolytischen Beizen von metallischen Bändern

Title (fr)

Procédé et dispositif pour le décapage électrolytique de bandes métalliques

Publication

**EP 0838542 A1 19980429 (DE)**

Application

**EP 97117775 A 19971014**

Priority

AT 187296 A 19961025

Abstract (en)

In the electrolytic pickling of metal strips, in particular, consisting of special steels, titanium, aluminium and nickel, the electric current passes through the strip in an indirect manner, that is, with an electric-ally conductive contact between the strip (2) and the electrodes (15, 16). The method is improved by the strip being transported vertically and that an electrolyte liquid (3) is introduced between the strip and the electrodes. Also claimed is an apparatus for implementation of the proposed method.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum elektrolytischen Beizen von Edelstahlbändern, wobei der elektrische Strom indirekt, d.h. ohne elektrisch leitende Berührung zwischen Band (3) und Elektroden (15),(16), durch das Band geleitet wird. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß das Band vertikal geführt und die Elektrolytflüssigkeit (24),(24') zwischen das Band und die Elektroden eingebracht wird. Weiters betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. <IMAGE>

IPC 1-7

**C25F 7/00**; **C25F 1/04**

IPC 8 full level

**C25F 3/02** (2006.01); **C25F 7/00** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**C25F 1/04** (2013.01 - EP KR US); **C25F 1/06** (2013.01 - KR); **C25F 1/08** (2013.01 - KR); **C25F 7/00** (2013.01 - EP KR US)

Citation (search report)

- [X] GB 2140036 A 19841121 - CENTRO SPERIMENT METALLURG
- [X] EP 0518850 A1 19921216 - ANDRITZ PATENTVERWALTUNG [AT]
- [A] US 3420760 A 19690107 - FREEDMAN BERNARD J, et al
- [A] US 3779877 A 19731218 - ALWITT R

Cited by

IT201700097032A1; DE19951325A1; DE19951325C2; DE19951324A1; DE19951324C2; US6979391B1; US6939455B1; WO2015091863A1; US6565735B1

Designated contracting state (EPC)

BE DE ES FI FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0838542 A1 19980429**; **EP 0838542 B1 20010613**; AT 406385 B 20000425; AT A187296 A 19990915; BR 9705144 A 19990223; CA 2218765 A1 19980425; CN 1192488 A 19980909; CN 1195905 C 20050406; DE 59703769 D1 20010719; ES 2159076 T3 20010916; ID 18748 A 19980507; KR 100487646 B1 20050902; KR 19980033150 A 19980725; MX 9708212 A 19980430; MY 123861 A 20060630; RU 2205254 C2 20030527; TW 531570 B 20030511; US 6120671 A 20000919

DOCDB simple family (application)

**EP 97117775 A 19971014**; AT 187296 A 19961025; BR 9705144 A 19971024; CA 2218765 A 19971020; CN 97121574 A 19971027; DE 59703769 T 19971014; ES 97117775 T 19971014; ID 973433 A 19971014; KR 19970054807 A 19971024; MX 9708212 A 19971024; MY PI19974649 A 19971003; RU 97117468 A 19971024; TW 86114511 A 19971004; US 95715597 A 19971024